附表

先前技術證據資料：

1. 德威公司人員與晟碟公司人員電子郵件往來紀錄乙件。(乙證 2，本院卷一第 191 至 194 頁)
2. 被告公司 In-line 濺鍍機(型號：[redacted])報價單乙件。(乙證 3，本院卷一第 195 頁)
3. 被告公司 In-line 濺鍍機(型號：[redacted])設備規格書乙件。(乙證 4，本院卷一第 197 至 206 頁)
4. 美國專利公告號第 5340454 號「Method and apparatus for the coating of substrates」之專利說明書公告本乙件。(乙證 10，本院卷一第 261 至 265 頁；中譯本，乙證 10-1，本院卷二第 21 至 23 頁)
5. 中華民國專利公告號第 M441293 號「適用於被動元件之雙面覆膜設備」之專利說明書公告本乙件。(乙證 11，本院卷一第 267 至 291 頁)
6. 美國專利公告號第 6843892 號「Apparatus and method for selectively and controllably electrically biasing a plurality of substrates on a pallet」之專利說明書公告本乙件。(乙證 12，本院卷一第 293 至 304 頁；中譯本，乙證 12-1，本院卷二第 25 至 36 頁)
7. 中國大陸專利公告號第 102650046B「一種規模化連續制備二維納米薄膜的裝置」之專利說明書公告本，其公開日為西元 2013 年 8 月 21 日(乙證 19，本院卷二第 145 至 160 頁)。
8. 中華民國專利公開號 TW 201032282A1「載送及處理基板之裝置與方法」之專利說明書公開本，其公開日為西元 2010 年 09 月 01 日(乙證 20，本院卷二第 161 至 204 頁)。
9. 中華民國專利公告號 M258101「自動化潛入式內部迴流裝置」之專利公報及專利說明書，其公開日為西元 2005 年 03 月 01 日(乙證 21，本院卷二第 205 至 236 頁)。

系爭專利 請求項號	主張法條	證據編號
1	專利法第 22 條第 2 項 (不具進步性)	乙證 2 至乙證 4 及乙證 10 之組合。 乙證 2 至乙證 4 及乙證 10、乙證 11 之組合。 乙證 12。 乙證 2 至乙證 4 及乙證 10 至乙證 12 之組合。 乙證 10 至乙證 12 之組合。
2、3、4	專利法第 22 條第 2 項 (不具進步性)	乙證 2 至乙證 4 及乙證 10 至乙證 12 及乙證 19 之組合。 乙證 10 至乙證 12 及乙證 19 之組合。
5~9	專利法第 22 條第 2 項 (不具進步性)	乙證 2 至乙證 4 及乙證 10 至乙證 12 及乙證 19 之組合。 乙證 10 至乙證 12 及乙證 19 之組合。 乙證 2 至乙證 4、乙證 10 至乙證 12、乙證 19 及引證 20 之組合。 乙證 10 至乙證 12、乙證 19 及引證 20 之組合。
10	專利法第 22 條第 2 項 (不具進步性)	乙證 2 至乙證 4、乙證 10 至乙證 12 及乙證 19 至引證 21 之組合。 乙證 10 至乙證 12 及乙證 19 至引證 21 之組合。